

# 2019年3月期 第2四半期決算説明会

---

2018年11月2日



# 本日説明のポイント

## 2019年3月期 上期業績

売上高 1,664億円（前年同期比 2.0%減）  
経常利益 6億円（前年同期比 53.0%減）

## 2019年3月期業績見通し

売上高 3,250億円（前年同期比 6.5%減）  
経常利益 34億円（前年同期比 18.2%減）

## 業績予想を修正

- 売上高 通信機器向け半導体の需要増
- 経常利益 為替変動の影響  
産業機器向け半導体の需要減や新規ビジネスの立ち上げ遅れ

# 2019年3月期 第2四半期 連結決算の概要

---

## 2019年3月期 上期 連結決算サマリ（前年同期比）

### ■売上高 1,664億円（前年同期比 34億円減、期初予想比 64億円増）

- デバイス事業 TV・PC向けメモリーICの減少
- システム事業 医用機器、航空宇宙機器の増加

### ■営業利益 25億円（前年同期比 8億円増、期初予想比 13億円増）

- 売上総利益 前年度末に円高進行で計上した外貨建て在庫評価損の戻し入れ

### ■経常利益 6億円（前年同期比 7億円減、期初予想比 4億円減）

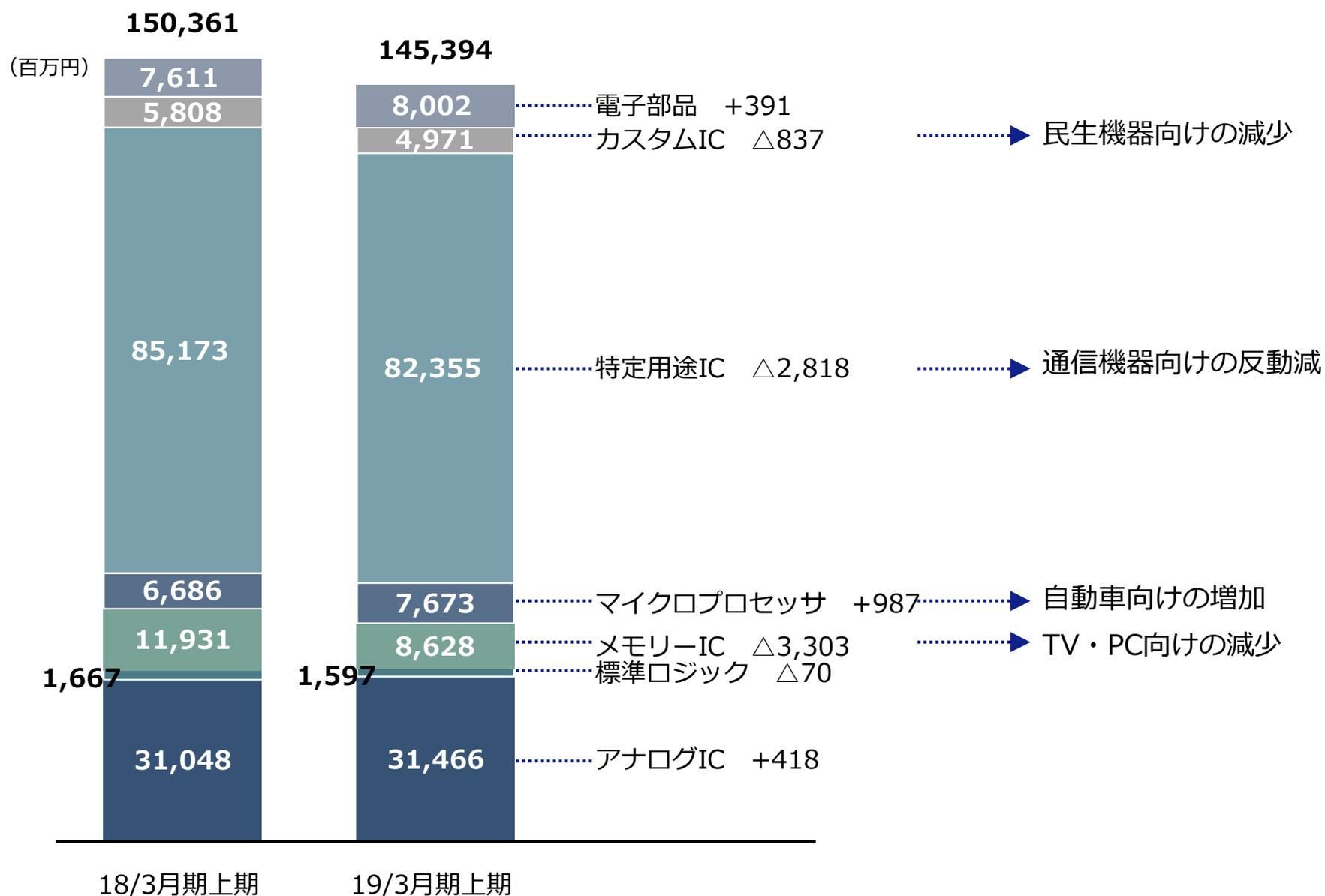
- 営業外費用 今年度期初からの円安進行による外貨建て債務の為替差損

### ■四半期純利益 1億円（前年同期比 2億円減、期初予想比 3億円減）

# 2019年3月期 上期 業績サマリ

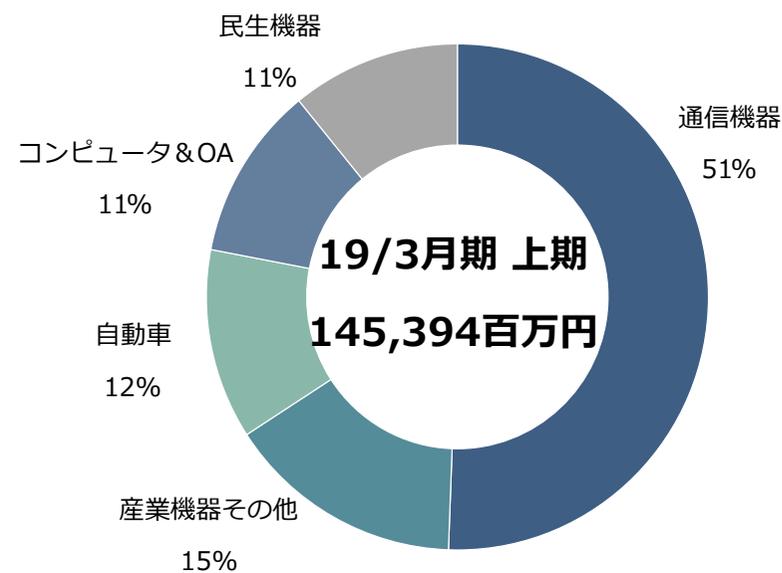
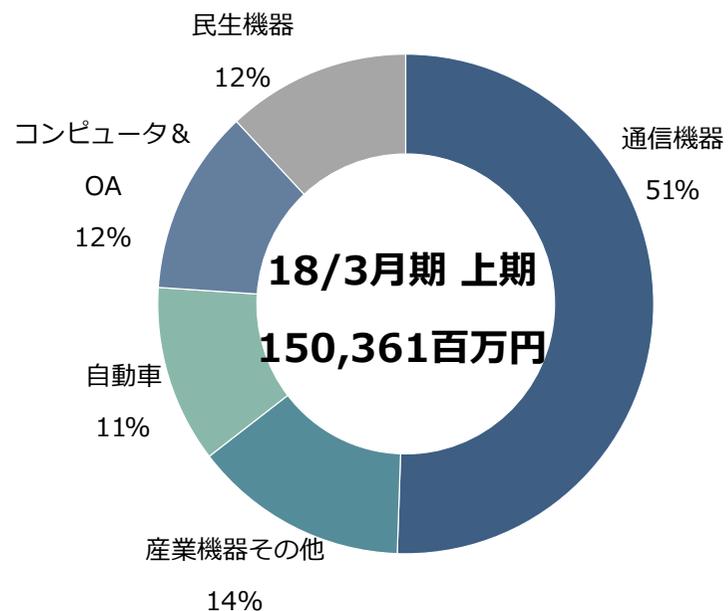
(百万円)	18/3月期 上期		19/3月期 上期			前年同期比		期初予想比
	実績	構成比	予想	実績	構成比	増減額	増減率	増減額
<b>売上高</b>	<b>169,875</b>	<b>100.0%</b>	<b>160,000</b>	<b>166,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 3,441</b>	<b>-2.0%</b>	<b>6,434</b>
デバイス事業	150,361	88.5%	139,000	145,394	87.4%	△ 4,967	-3.3%	6,394
システム事業	19,513	11.5%	21,000	21,040	12.6%	1,527	7.8%	40
<b>売上総利益</b>	<b>10,272</b>	<b>6.0%</b>	<b>10,200</b>	<b>11,382</b>	<b>6.8%</b>	<b>1,110</b>	<b>10.8%</b>	<b>1,182</b>
販管費	8,518	5.0%	8,950	8,807	5.3%	289	3.4%	△ 143
人件費	5,159	3.0%	-	5,292	3.2%	133	2.6%	-
その他	3,358	2.0%	-	3,514	2.1%	156	4.6%	-
<b>営業利益</b>	<b>1,753</b>	<b>1.0%</b>	<b>1,250</b>	<b>2,575</b>	<b>1.5%</b>	<b>822</b>	<b>46.9%</b>	<b>1,325</b>
営業外収益	319	0.2%	250	296	0.2%	△ 23	-7.2%	46
営業外費用	757	0.4%	480	2,254	1.4%	1,497	197.8%	1,774
<b>経常利益</b>	<b>1,314</b>	<b>0.8%</b>	<b>1,020</b>	<b>617</b>	<b>0.4%</b>	<b>△ 697</b>	<b>-53.0%</b>	<b>△ 403</b>
特別利益	0	0.0%	-	23	0.0%	23	-	23
特別損失	211	0.1%	-	17	0.0%	△ 194	-91.9%	17
<b>親会社株主に帰属 する四半期純利益</b>	<b>390</b>	<b>0.2%</b>	<b>465</b>	<b>133</b>	<b>0.1%</b>	<b>△ 257</b>	<b>-65.9%</b>	<b>△ 332</b>
<b>期末従業員数 (名)</b>	<b>1,408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,350</b>	<b>-</b>	<b>△ 58</b>	<b>-4.1%</b>	<b>-</b>

# 2019年3月期 上期 『デバイス事業』 品目別売上高

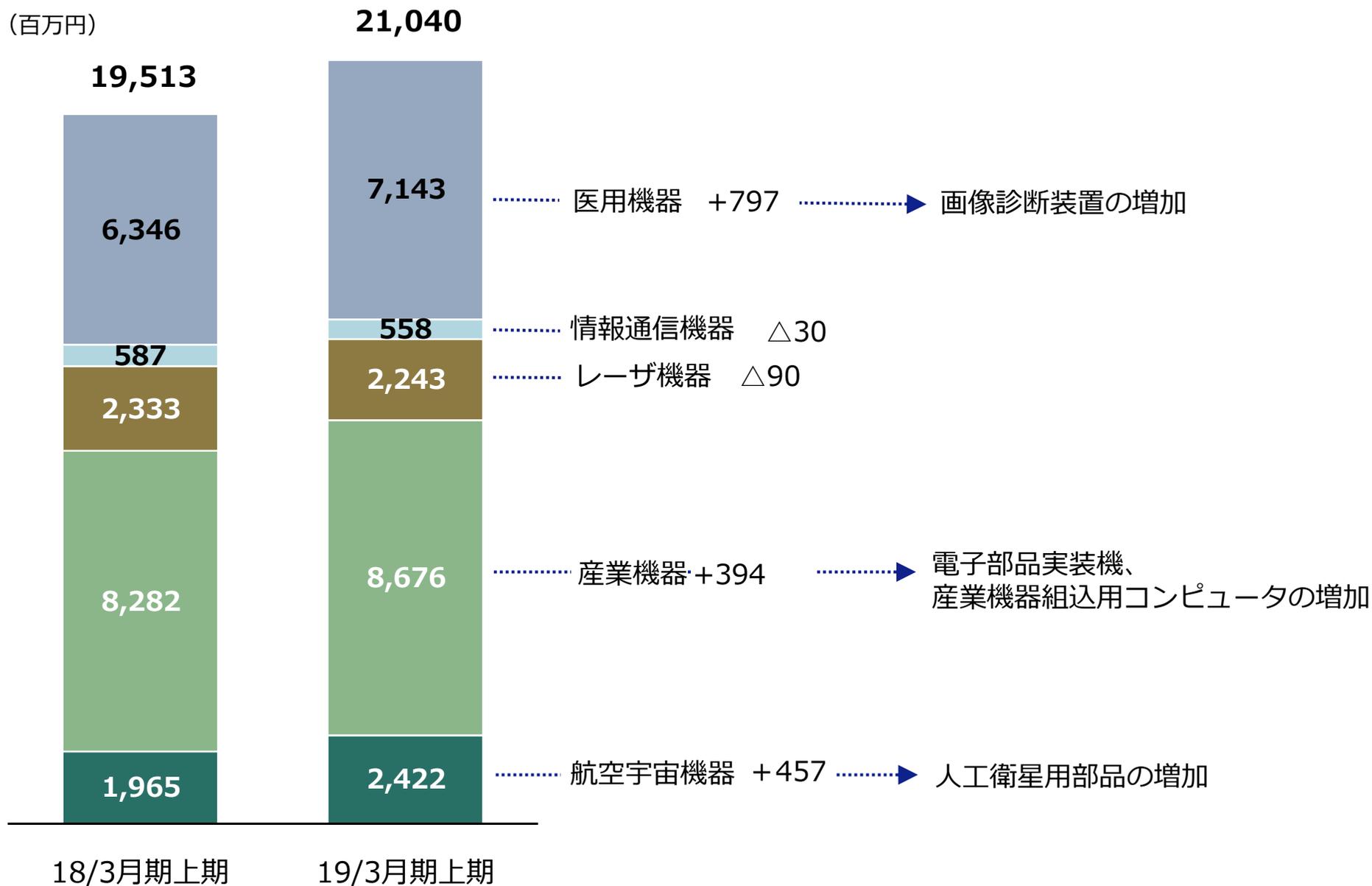


# 2019年3月期 上期 『デバイス事業』 用途別市場動向

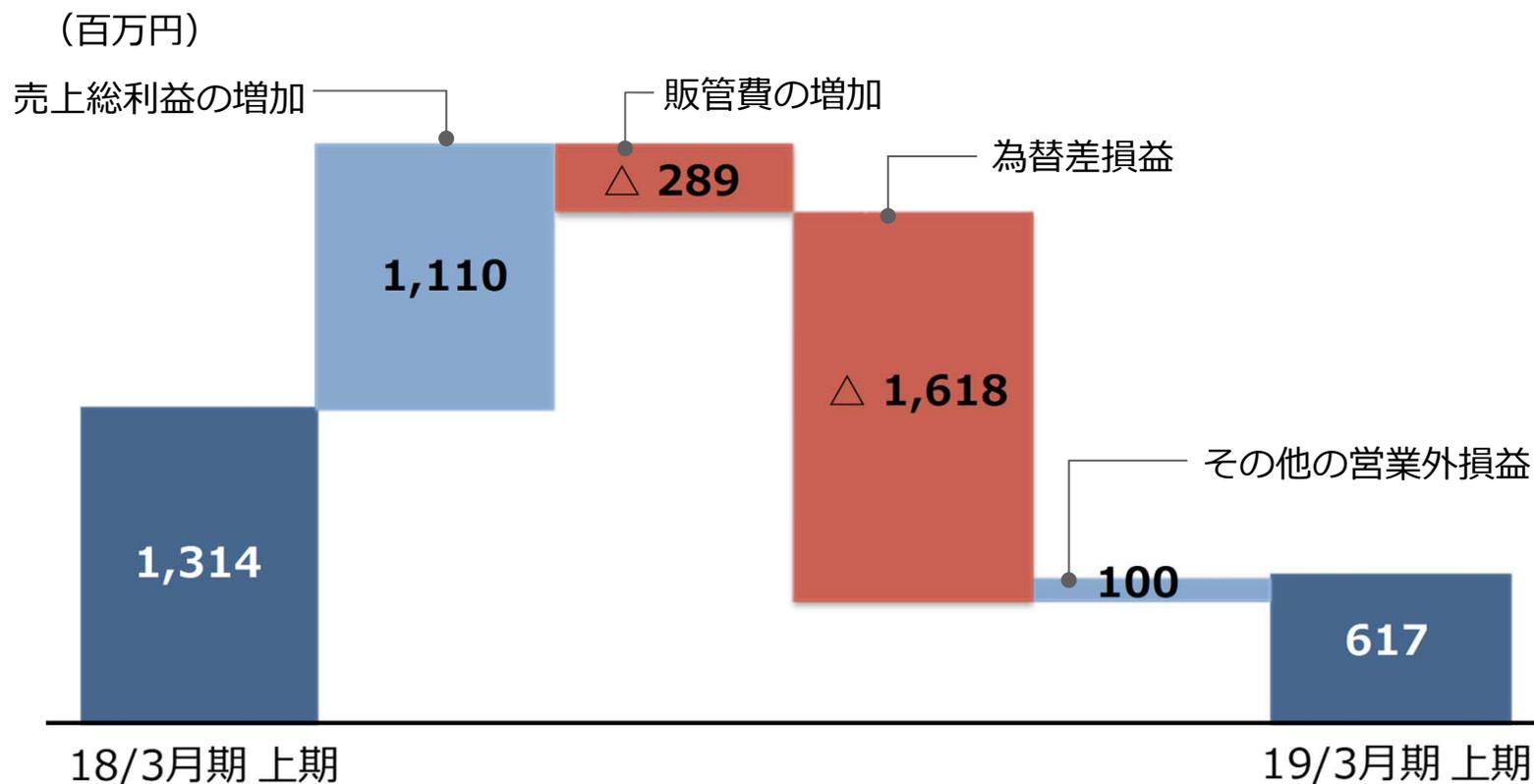
用途	市場動向
産業機器その他	➡ 工作機械などFA機器向けが増加
自動車	➡ 車内通信向けで増加
通信機器	➡ 通信機器向けが減少
コンピュータ&OA	➡ PC向けが減少
民生機器	➡ TV向けが減少



# 2019年3月期 上期 『システム事業』 品目別売上高



# 2019年3月期 上期 経常利益の増減要因



売上総利益	<b>前年度末計上の在庫評価損の戻し入れ、今年度期初からの円安による差益増</b> 18/3月期上期：102億円 → 19/3月期上期：113億円
販管費	<b>人件費・業務委託費の増加</b> 17/3月期上期：85億円 → 18/3月期上期：88億円
営業外損益	<b>為替差損の計上</b> 17/3月期上期：差益6百万円 → 18/3月期上期：差損16億円

## 2019年3月期 上期 貸借対照表の概要

(百万円)	18/3月期末 実績	18/3月期 上期末 実績	前期末比 増減額	主な増減理由
<b>資産合計</b>	<b>135,706</b>	<b>137,315</b>	<b>1,609</b>	受取手形及び売掛金 5,354
流動資産	122,297	123,569	1,272	商品及び製品 △ 6,943
固定資産	13,408	13,746	338	
<b>負債合計</b>	<b>86,529</b>	<b>88,669</b>	<b>2,140</b>	支払手形及び買掛金 1,886
流動負債	75,765	78,220	2,455	
固定負債	10,763	10,448	△ 315	
<b>純資産合計</b>	<b>49,177</b>	<b>48,646</b>	<b>△ 531</b>	

# 中期経営計画 事業戦略と重点施策

---

## 業界再編の動き

半導体メーカー

さらなる集約化の動き

エレクトロニクス商社

経営統合やM&Aが進む

## 半導体業界のテーマ

AI・ロボット・IoT技術

利用促進

多くのプレイヤーの参入

混沌とした状況

# 2016-2018年度 中期経営計画方針

## 2019年3月期を最終年度とする中期経営計画

業界再編への対応、  
キャッチアップ

イノベーションへの  
積極投資による  
新規事業創造

資本効率の向上

持続的な成長の実現

# 『デバイス事業』 4つの取り組み

## デバイス事業

- ① ベースビジネスの強化
- ② 成長市場での事業強化
- ③ 新規商材の事業化推進
- ④ グローバル展開の加速

# ① ベースビジネスの強化

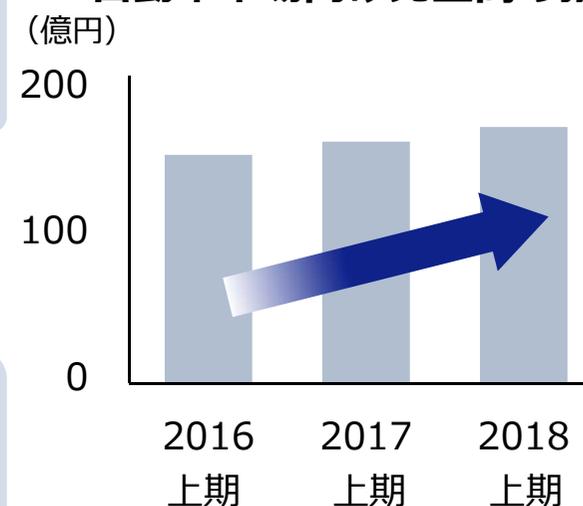
## ■ デマンドクリエーション活動の推進

- アナログ/ワイヤレスなどキーデバイスの販売体制拡充

## ■ 自動車市場でのソリューション開発の強化

- 自動運転/EV/ハイブリッド/ネットワークに注力
- 先進的サプライヤとの提携
  - ・ モーター制御用コントローラICの取り扱いを開始
- 点から面での提案活動を展開

自動車市場向け売上高の推移



Silicon Mobility社  
モーター制御用コントローラIC

## ① ベースビジネスの強化

### ■ 産業機器・マスマーケット市場に対する取り組み

- 専従組織を設置
- デジタルマーケティングを推進

### ■ 事業基盤の強化と経営の効率化

- KTLを丸文に統合
- 丸文セミコンの事業を株式会社トーメンデバイスに譲渡

## ② 成長市場での事業強化

### 医療・ヘルスケア分野

#### MC10社

##### ■ バイオセンサー

- フィットネスやウェアなどヘルスケア向けでも様々な企業と実証実験



### IoT分野

#### Afero社

##### ■ IoTプラットフォーム

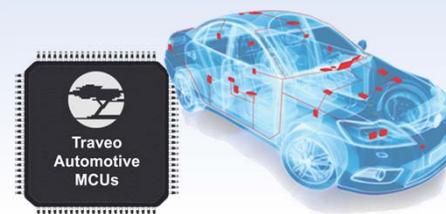
- スマートロック等で採用促進



#### Cypress社

##### ■ IoT向け無線関連製品

- 主カビジネスに成長



### ③ 新規商材の事業化推進

従来の半導体販売とは違った  
新しいビジネスモデルの立ち上げ

#### FINsix社

##### ■ 豊田自動織機様と共同開発

- 自動車用インバータ

順調に進捗



#### Nanoramic Laboratories社

##### ■ ナノカーボン製品を取扱い

- 高品質の熱伝導素材
- 耐熱性や強度に優れた小型キャパシタ



## ④ グローバル展開の加速

欧州

自動車向けビジネス  
順調な立ち上がり

アジア・北米

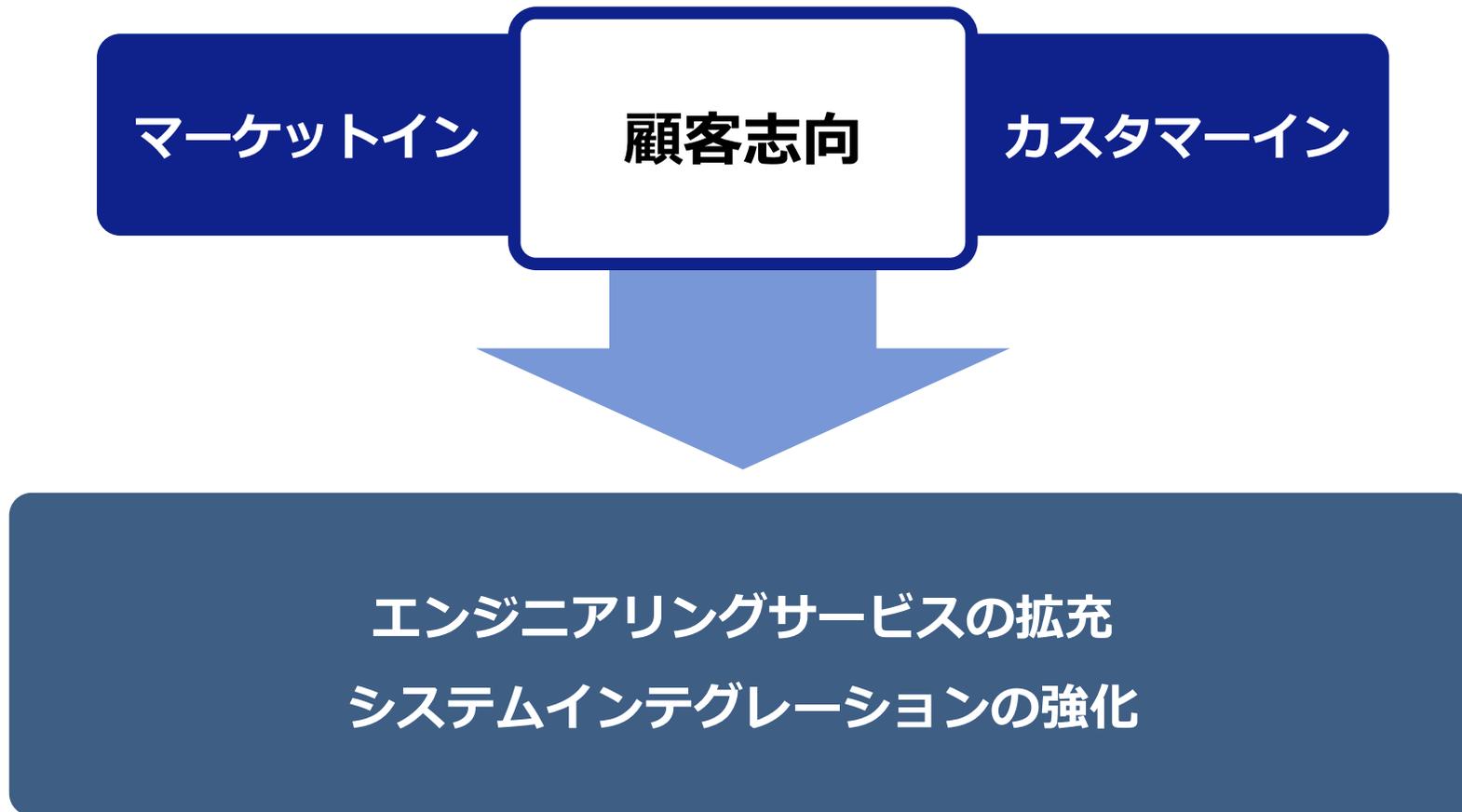
自動車向けビジネス好調  
更なる伸びを期待

丸文アロー  
ヨーロッパ

丸文アロー  
USA

丸文アロー  
アジア

# 『システム事業』の取り組み



# 『システム事業』 分野別の取り組み

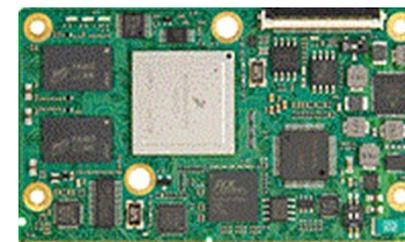
## 航空宇宙機器

- 人工衛星・ロケット向け高信頼性部品、コンポーネントの取り込みに注力



## 産業機器

- 車載・スマートフォン向け電子部品の検査装置・不良解析装置の販売に注力
- 産業機器向け組込コンピュータを拡販



ADLINK社  
組込み用コンピュータ

## レーザ機器

- 産業機器組込み用レーザと医療機器向け光源の拡販を推進



nLight社  
組込み用半導体レーザ

# 『システム事業』 分野別の取り組み

## 情報通信機器

- 5G移動通信システムの実用化に向け  
キャリア・通信インフラメーカーへ積極販売
- Septentrio社の高精度GPS受信機を  
自動運転や農機向けに販売開始



Septentrio社  
高精度GPS受信機

## 医療機器

- 先端医用機器の商材開発
- エンジニア増強によるメンテナンスサービスの  
拡充



# 2019年3月期 業績予想の概要

---

# 2019年3月期 業績予想サマリ

## ■売上高 3,250億円（前期比 225億円減、期初予想比 100億円増）

- デバイス事業 通信機器向けの減少、TV・PC向けメモリーICの減少
- システム事業 航空宇宙機器、レーザ機器、産業機器の増加

## ■営業利益 58億円（前期比 20億円増、期初予想比 11億円増）

- 売上総利益 前年度末計上の在庫評価損の戻し入れ、  
今年度上期の円安による差益額の増加

## ■経常利益 34億円（前期比 7億円減、期初予想比 8億円減）

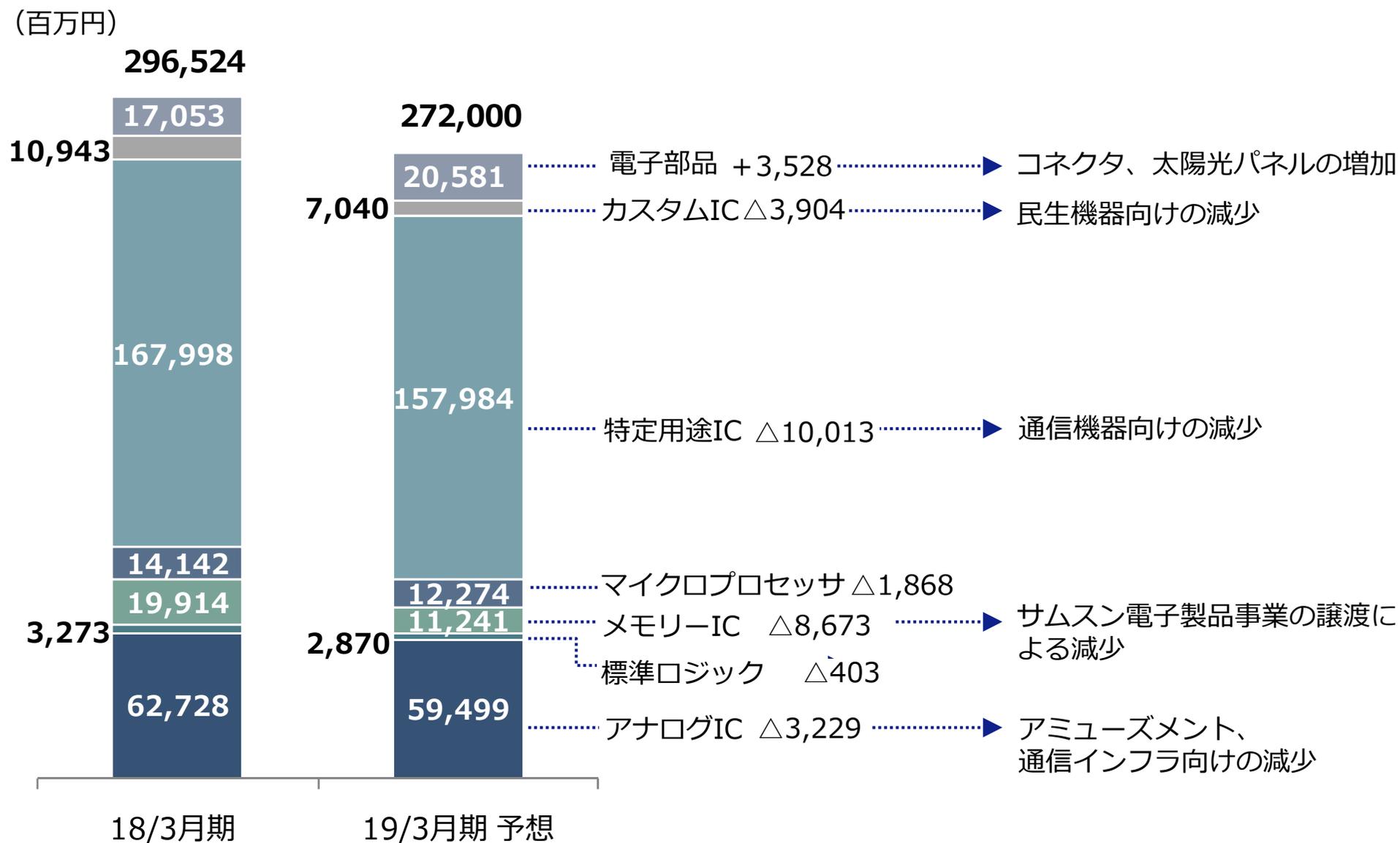
- 営業外費用 上期計上の為替差損の影響、支払利息の増加

## ■当期純利益 18億円（前期比 2億円減、期初予想比 7億円減）

# 2019年3月期 業績予想サマリ

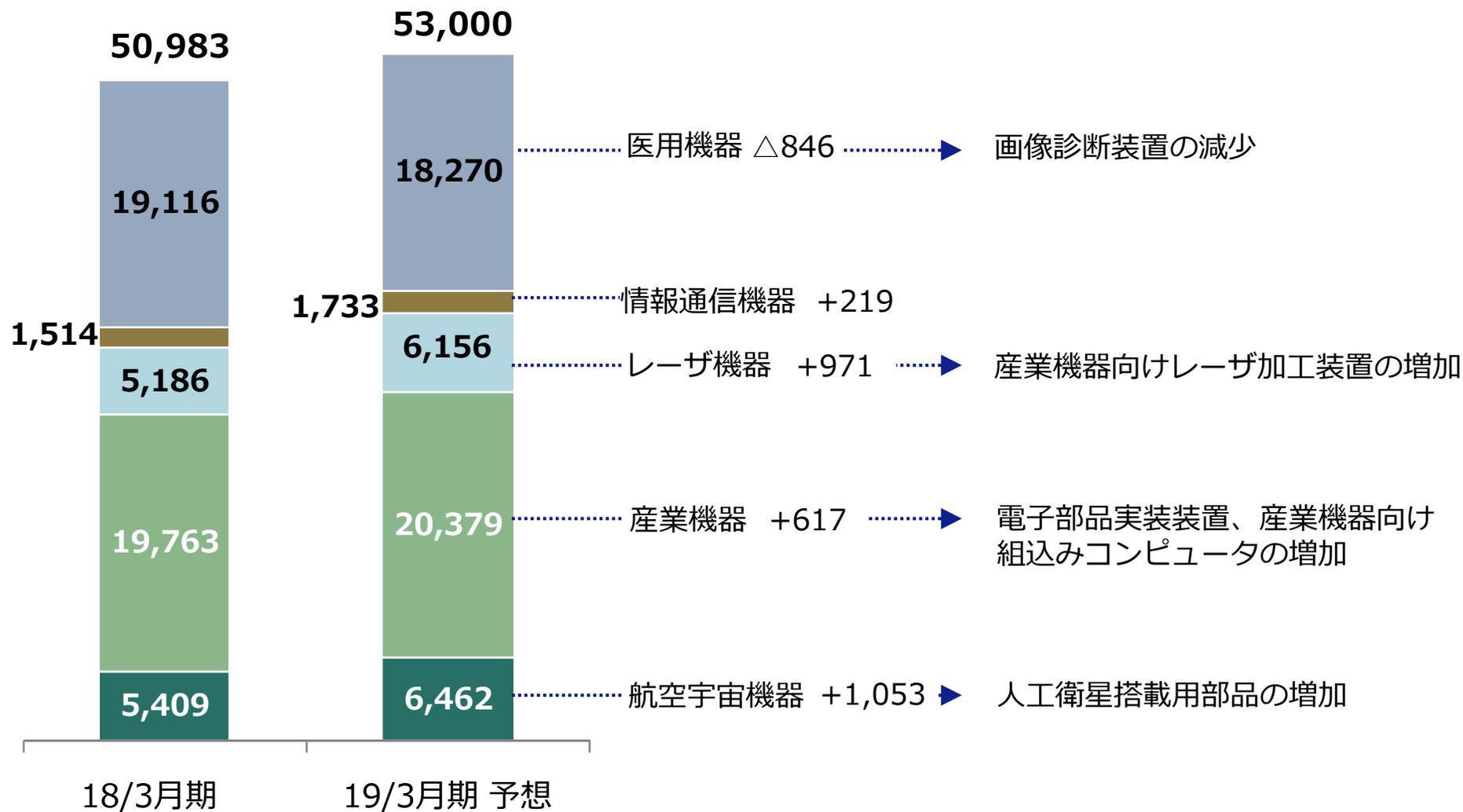
(百万円)	18/3月期		19/3月期予想			前期比		期初予想比
	実績	構成比	期初予想	修正予想	構成比	増減額	増減率	増減額
<b>売上高</b>	<b>347,508</b>	<b>100.0%</b>	<b>315,000</b>	<b>325,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 22,508</b>	<b>-6.5%</b>	<b>10,000</b>
デバイス事業	296,524	85.3%	262,500	272,000	83.7%	△ 24,524	-8.3%	9,500
システム事業	50,983	14.7%	52,500	53,000	16.3%	2,017	4.0%	500
<b>売上総利益</b>	<b>21,161</b>	<b>6.1%</b>	<b>22,500</b>	<b>23,300</b>	<b>7.2%</b>	<b>2,139</b>	<b>10.1%</b>	<b>800</b>
販管費	17,390	5.0%	17,800	17,500	5.4%	110	0.6%	△ 300
<b>営業利益</b>	<b>3,771</b>	<b>1.1%</b>	<b>4,700</b>	<b>5,800</b>	<b>1.8%</b>	<b>2,029</b>	<b>53.8%</b>	<b>1,100</b>
営業外収益	1,773	0.5%	550	550	0.2%	△ 1,223	-69.0%	0
営業外費用	1,327	0.4%	950	2,900	0.9%	1,573	118.5%	1,950
<b>経常利益</b>	<b>4,218</b>	<b>1.2%</b>	<b>4,300</b>	<b>3,450</b>	<b>1.1%</b>	<b>△ 768</b>	<b>-18.2%</b>	<b>△ 850</b>
特別利益	6	0.0%	-	25	-	19	-	25
特別損失	311	0.1%	-	25	-	△ 286	-	25
<b>親会社株主に帰属 する当期純利益</b>	<b>2,077</b>	<b>0.6%</b>	<b>2,500</b>	<b>1,800</b>	<b>0.6%</b>	<b>△ 277</b>	<b>-13.3%</b>	<b>△ 700</b>

# 2019年3月期『デバイス事業』品目別売上高予想

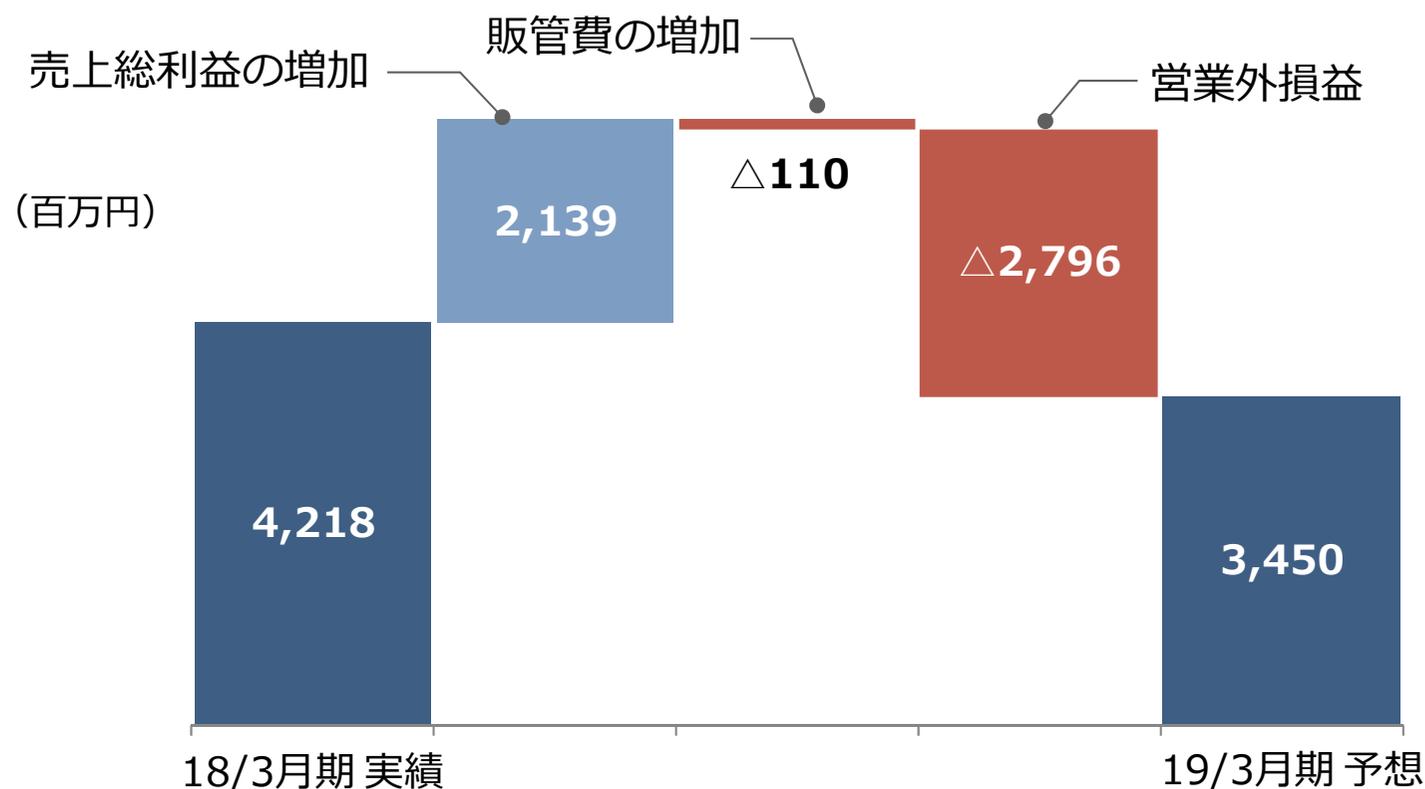


# 2019年3月期 『システム事業』 品目別売上高予想

(百万円)



## 経常利益の増減要因（前期 vs. 予想）



売上総利益	<b>前年度末計上の在庫評価損の戻し入れ、今年度期初からの円安による差益増加</b> 18/3月期：211億円(利益率6.1%) → 19/3月期予想：233億円(7.2%)
販管費	<b>前年度並み</b> 18/3月期：174億円 → 19/3月期予想：175億円
営業外損益	<b>為替差損益</b> 18/3月期：為替差益11億円 → 19/3月期予想：上期に差損16億円を計上

# 株主還元

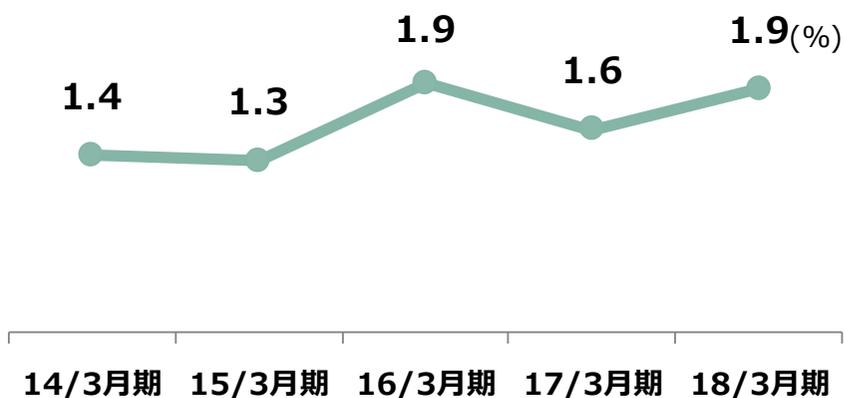
---

# 株主還元

## ■ 配当方針

配当性向 連結30%以上

■ DOE(株主資本配当率)の推移



## ■ 配当予想

(円)	18/3月期	19/3月期 (予想)
1株当たり年間配当金	30.00	30.00
中間配当	10.00	10.00
期末配当	20.00	20.00
	(記念配当5円含む)	

# 参考情報

---

# 企業概況

## 会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 水野象司
売 上 高	連結 3,475億円（2018年3月期） 単体 2,278億円（2018年3月期）
従業員数	連結 1,381名（2018年3月末） 単体 670名（2018年3月末）
株式上場	東京証券取引所 市場第一部（コード:7537）

## 事業領域

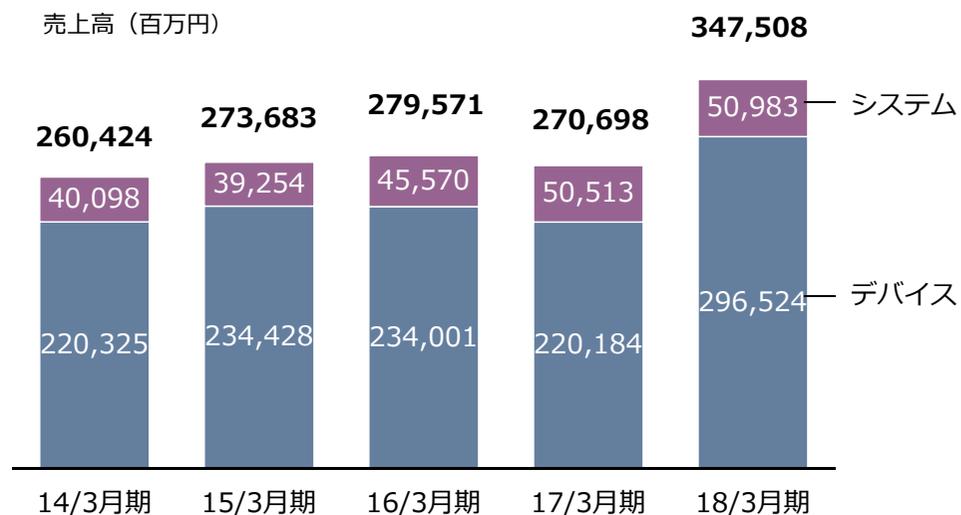
### デバイス事業

- 半導体
- 電子部品

### システム事業

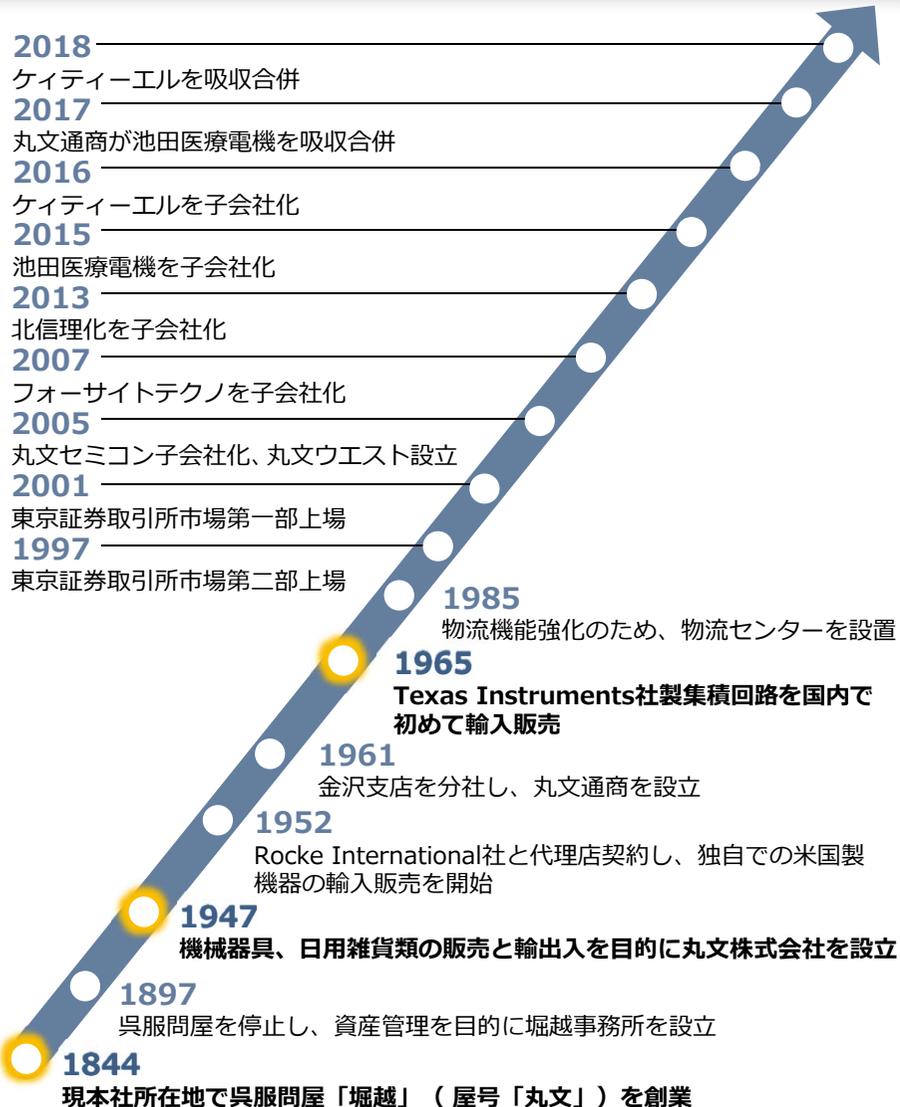
- 航空宇宙機器
- 産業機器
- レーザ機器
- 情報通信機器
- 医用機器

## 連結売上高の推移

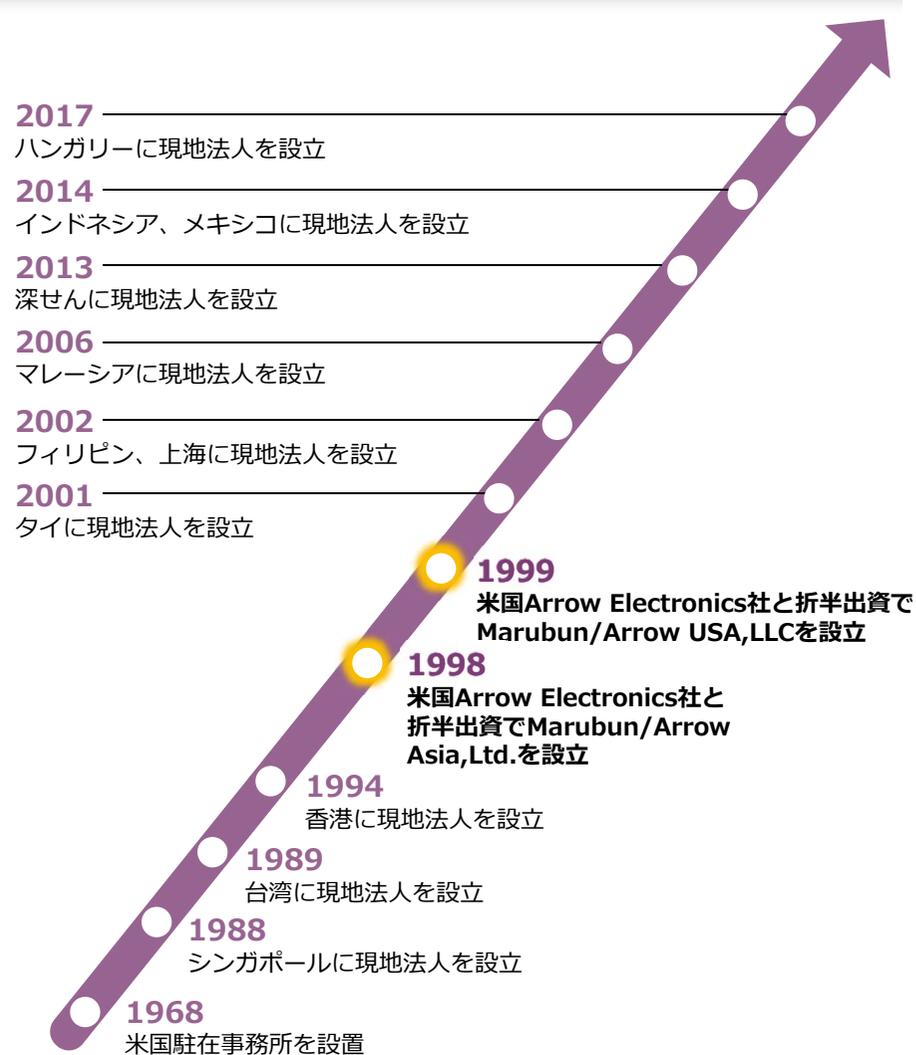


# 沿革

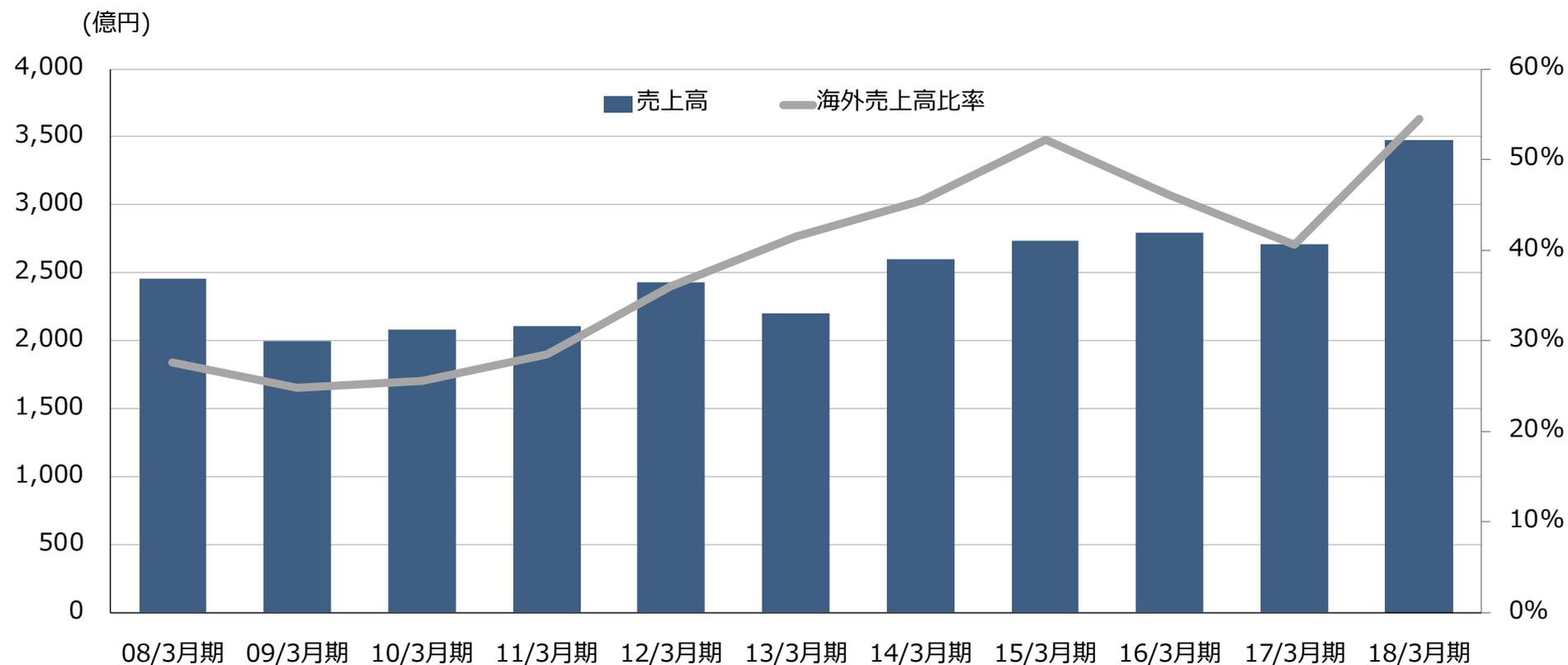
## 国内

- 
- 2018 ケイティーエルを吸収合併
  - 2017 丸文通商が池田医療電機を吸収合併
  - 2016 ケイティーエルを子会社化
  - 2015 池田医療電機を子会社化
  - 2013 北信理化を子会社化
  - 2007 フォーサイトテクノを子会社化
  - 2005 丸文セミコン子会社化、丸文ウエスト設立
  - 2001 東京証券取引所市場第一部上場
  - 1997 東京証券取引所市場第二部上場
  - 1985 物流機能強化のため、物流センターを設置
  - 1965 Texas Instruments社製集積回路を国内で初めて輸入販売
  - 1961 金沢支店を分社し、丸文通商を設立
  - 1952 Rocke International社と代理店契約し、独自の米国製機器の輸入販売を開始
  - 1947 機械器具、日用雑貨類の販売と輸出入を目的に丸文株式会社を設立
  - 1897 呉服問屋を停止し、資産管理を目的に堀越事務所を設立
  - 1844 現本社所在地で呉服問屋「堀越」（屋号「丸文」）を創業

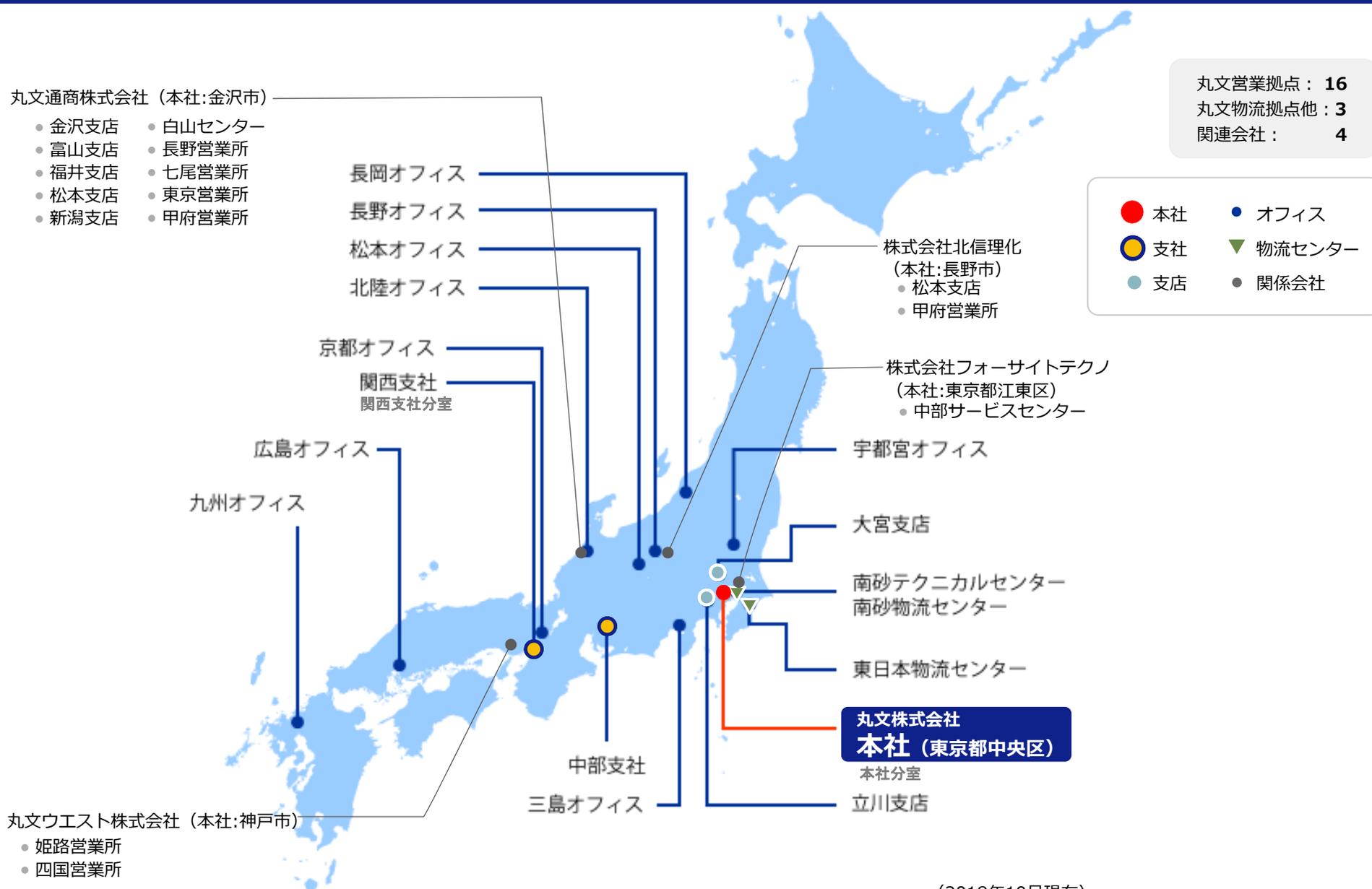
## 海外

- 
- 2017 ハンガリーに現地法人を設立
  - 2014 インドネシア、メキシコに現地法人を設立
  - 2013 深センに現地法人を設立
  - 2006 マレーシアに現地法人を設立
  - 2002 フィリピン、上海に現地法人を設立
  - 2001 タイに現地法人を設立
  - 1999 米国Arrow Electronics社と折半出資でMarubun/Arrow USA,LLCを設立
  - 1998 米国Arrow Electronics社と折半出資でMarubun/Arrow Asia,Ltd.を設立
  - 1994 香港に現地法人を設立
  - 1989 台湾に現地法人を設立
  - 1988 シンガポールに現地法人を設立
  - 1968 米国駐在事務所を設置

## 中長期トレンド（売上高・海外売上高比率）

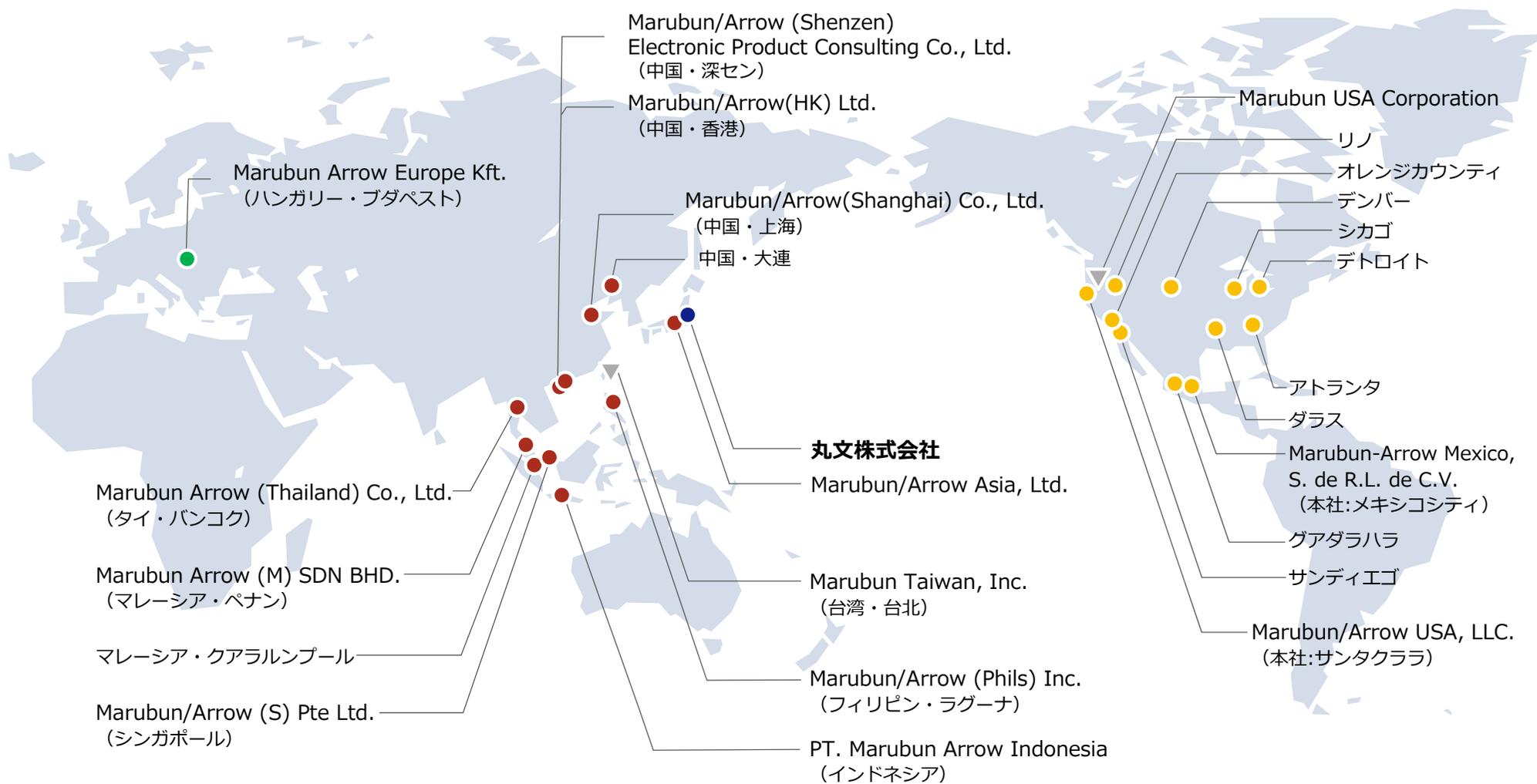


# 国内拠点



(2018年10月現在)

# グローバルネットワーク



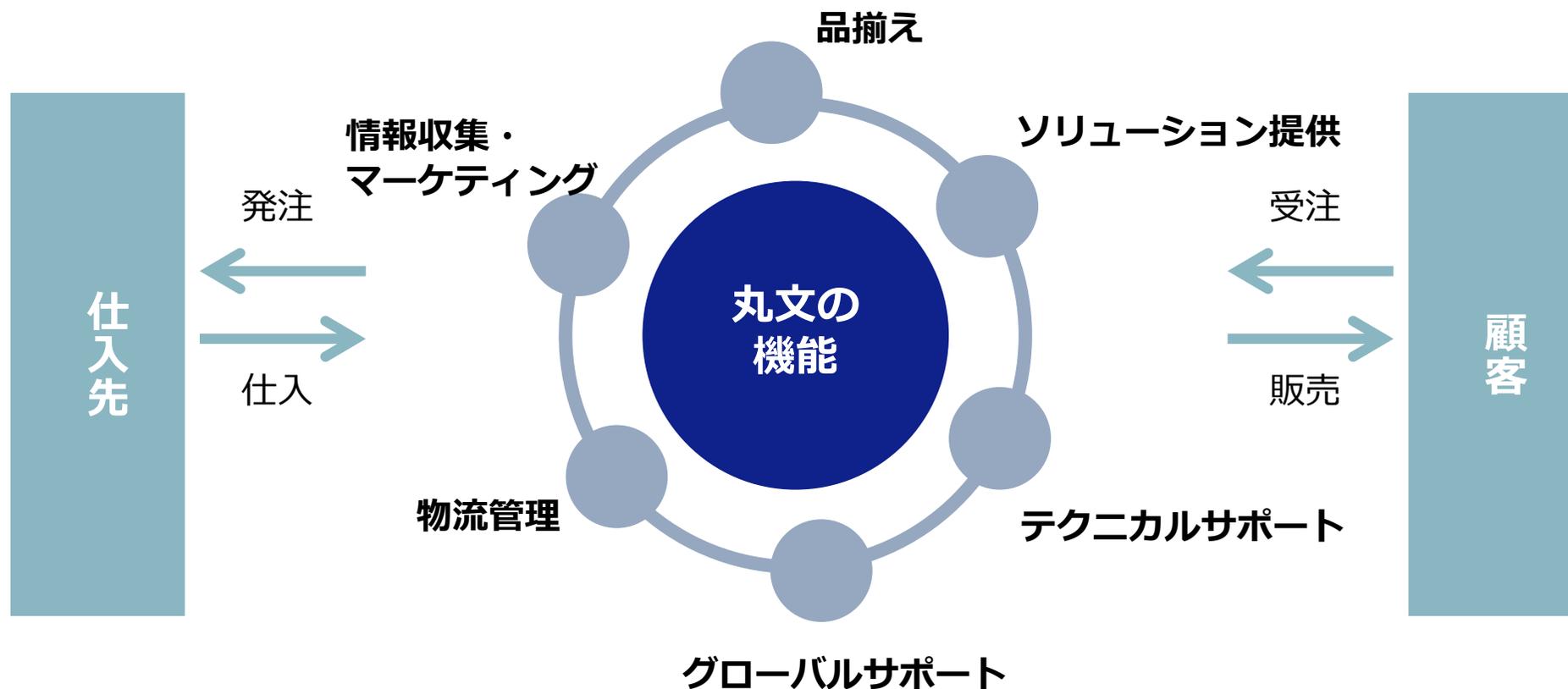
アジア拠点 : 12  
北米拠点 : 12  
欧州拠点 : 1

(2018年10月現在)

- 丸文株式会社
- Marubun/Arrow Asia, Ltd.
- Marubun/Arrow USA, LLC.
- Marubun Arrow Europe Kft.
- ▼ その他

# デバイス事業：特徴と強み

- 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え
- 米国アロー社(80ヶ国、345拠点)との提携によるグローバルネットワーク
- 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力
- 強固な顧客基盤



# デバイス事業：グループ会社概要

社名	住所	設立年月	出費比率	事業内容
Marubun USA Corporation	California, U.S.A.	1983年10月	100%	丸文アローUSAの持株会社
Marubun Taiwan, Inc.	Taipei, Taiwan	1989年11月	100%	台湾製デバイスの仕入販売
Marubun/Arrow Asia, Ltd.	British Virgin Islands	1998年10月	50%	丸文アローシンガポール、 丸文アロー香港の持株会社
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.	Anson Road, Singapore	1988年3月	50%	
Marubun/Arrow (HK) Ltd.	Hong Kong, China	1994年8月	50%	
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand	2000年10月	50%	
Marubun/Arrow (Phils), Inc.	Laguna, Philippines	2001年10月	50%	
Marubun Arrow (M) SDN BHD	Penang, Malaysia	2006年6月	50%	
Marubun/Arrow (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai, China	2002年9月	50%	海外進出した日系企業への 半導体・電子部品の仕入販売
Marubun/Arrow (Shenzhen) Electronic Product Consulting Co.,Ltd.	Shenzhen, China	2013年6月	50%	
PT. Marubun Arrow Indonesia	Jakarta, Indonesia	2014年4月	50%	
Marubun/Arrow USA, LLC*	Delaware, U.S.A.	1998年11月	50%	
Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V.*	MexicoCity, MEXICO	2014年9月	50%	
Marubun Arrow Europe Kft.*	Budapest, Hungary	2017年11月	50%	

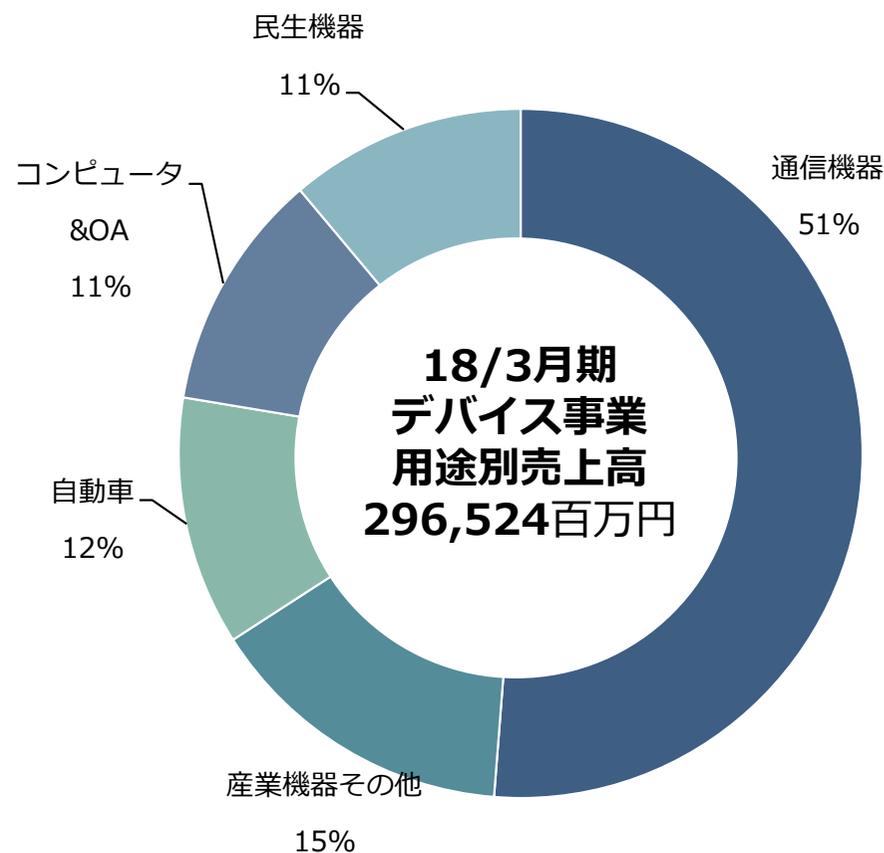
\* Marubun/Arrow USA、Marubun-Arrow Mexico、Marubun Arrow Europe Kft.は持分法適用の関連会社です。

# デバイス事業：取扱製品（サプライヤ別）

		サプライヤ（アルファベット順）														
		旭化成 エレクトロニクス	エイブリック	Broadcom (米国)	Cypress (米国)	Eink (台湾)	FINSix (米国)	IDT (米国)	Littlefuse (米国)	Maxim (米国)	Molex (米国)	Qorvo (米国)	SanDisk (米国)	セイコー エプソン	TexasInstruments (米国)	その他
半 導 体	アナログIC	●	●	●				●	●		●			●	●	
	標準ロジックIC														●	
	メモリーIC	DRAM														●
		フラッシュ											●			●
		その他メモリー		●				●					●			●
	マイクロ プロセッサ	MPU、MCU												●	●	●
		DSP	●												●	●
	特定用途IC	ASSP	●		●	●			●	●		●		●	●	●
		ディスプレイドライバ												●	●	
		DMD													●	
LED															●	
カスタムIC	●												●	●		
電 子 部 品	表示デバイス					●									●	
	水晶デバイス		●					●					●			
	コネクタ・スイッチ・プリント基板									●					●	
	モジュール製品						●								●	

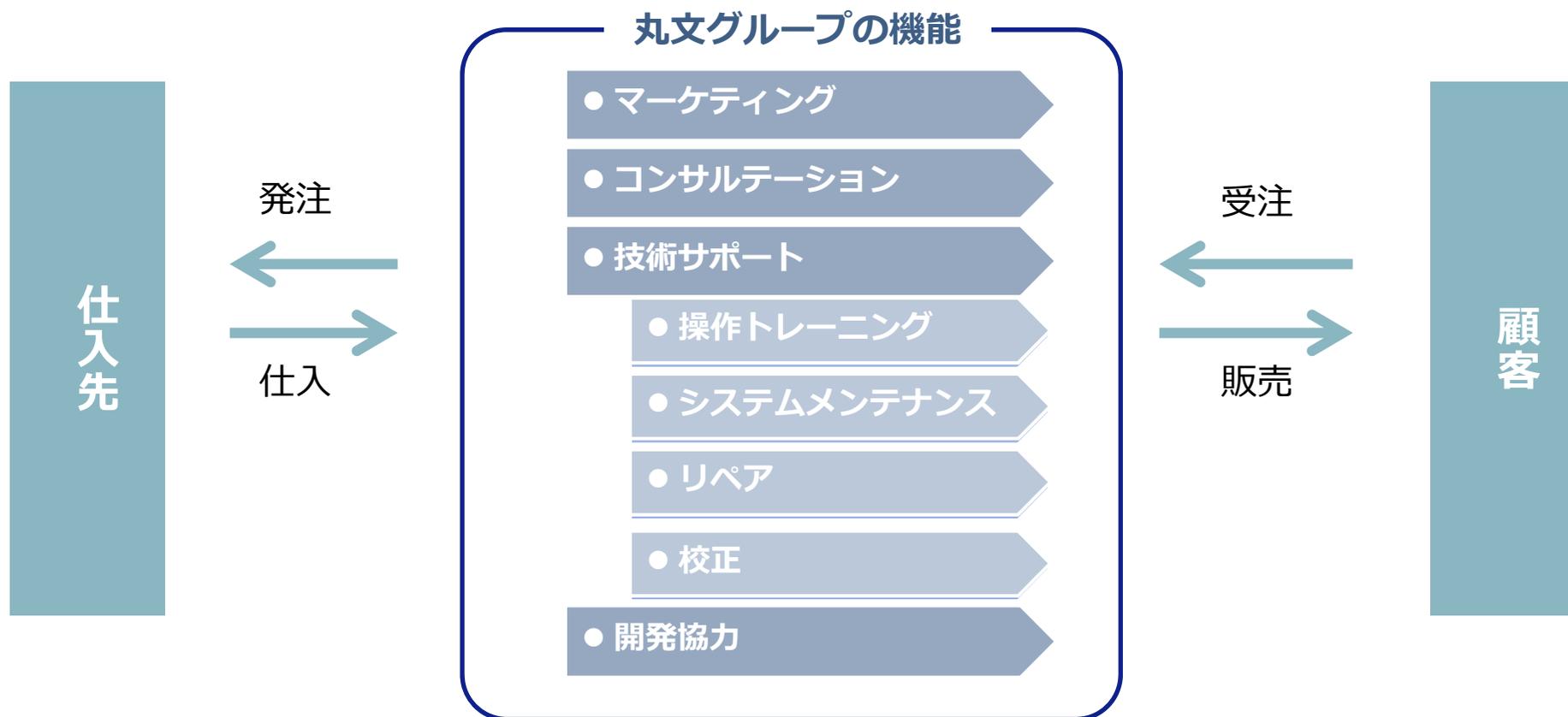
# デバイス事業：主要取扱い製品（用途別）

		通信機器	コンピュータ	産業機器	自動車	民生機器
<b>半導体</b>						
アナログIC	アナログ	●	●	●	●	●
	ディスクリート	●		●	●	●
標準ロジックIC		●	●	●	●	●
メモリーIC	DRAM	●	●		●	●
	フラッシュ	●	●			●
マイクロプロセッサ	MPU、MCU	●	●	●	●	●
	DSP	●		●	●	●
特定用途IC	ASSP	●			●	●
	ディスプレイドライバ	●	●		●	●
	DMD	●	●	●	●	●
	LED	●	●			●
カスタムIC		●	●		●	●
<b>電子部品</b>						
表示デバイス		●	●	●	●	●
水晶デバイス		●		●	●	●
コネクタ・スイッチ・プリント基板		●				●
モジュール製品			●		●	●



# システム事業：特徴と強み

- ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供
- システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート

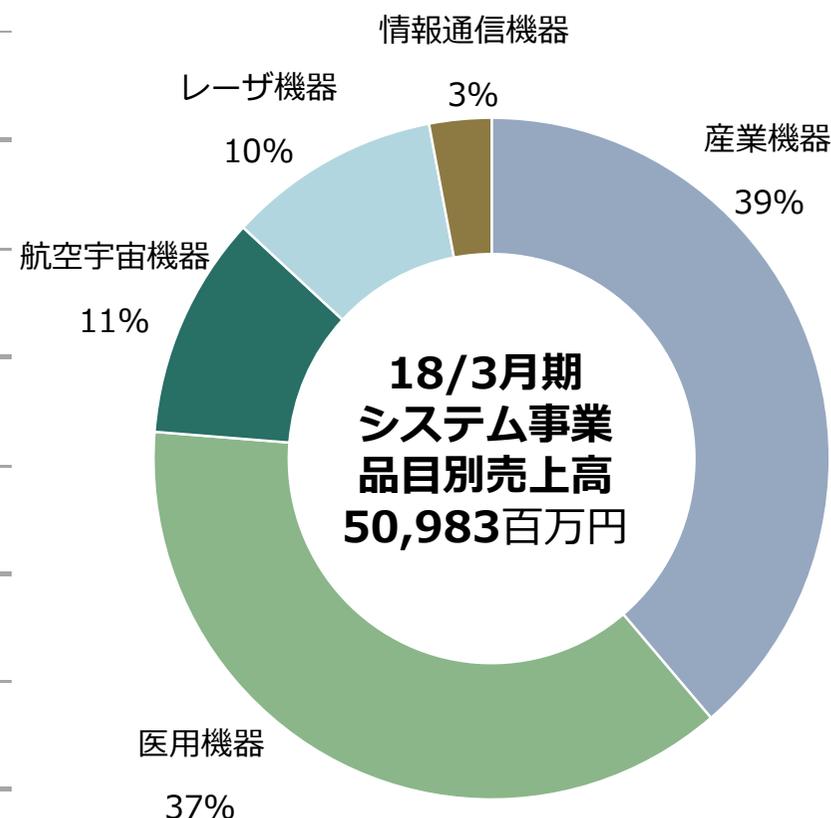


## システム事業：グループ会社概要

社名	本社	設立年月	出費比率	事業内容
丸文通商株式会社	石川県金沢市	1961年3月	100%	医用機器および試験計測機器の仕入販売・修理・メンテナンス
丸文ウエスト株式会社	兵庫県神戸市	2005年5月	100%	試験計測機器の仕入販売
株式会社北信理化	長野県長野市	1951年11月	100%	試験計測機器の仕入販売
株式会社フォーサイトテクノ	東京都江東区	1999年3月	51%	システム製品の修理・メンテナンス、エンジニアリングサービス

# システム事業：主要取扱い製品①

分野	主要取扱商品	主要仕入先
産業機器	検査装置 組込・検査装置	ユニハイトシステム、FEI、島津製作所、 アキム、セイコーエプソン
	組込ソリューション 科学機器	ARTESYN、Aitech、ADLINK、 LayTec、Riber
	画像診断機器	シーメンス、島津製作所、 コニカミノルタヘルスケア
	人工透析機器	日機装、旭化成メディカル、 カネカメディックス
レーザ機器	半導体レーザ レーザ加工機	nLight、Laserline
	光機器	Excelitas Technologies、 Luminus Devices、First Sensor
航空宇宙機器	宇宙関連機器 計測・センサ	Tele Communication Systems、 GEセンシング、Meggit、Plascore
	航空関連機器 高周波電子機器	TEXTRON、L3 Technologies、 CPI、Bird
	RF・光通信 測位タイミング	PCTEL、Finisar、EXFO、 Microsemi、Calnex、Spirent



## システム事業：主要取扱い製品②

### 航空宇宙機器



BEI Sensors社  
高信頼性部品



CPI社  
マイクロ波電子管

### 産業機器

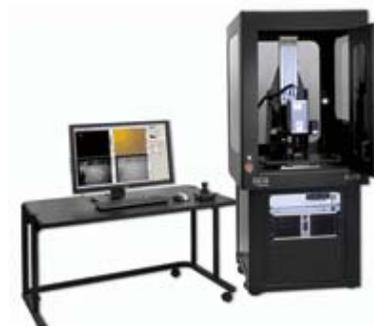


島津製作所  
ガスクロマトグラフ質量分析計



アキム  
電子部品組立装置

DCG  
Systems



FEI社  
赤外線発熱解析装置



FUJI  
大気圧プラズマ表面改質装置

## システム事業：主要取扱い製品③

### レーザ機器



nLIGHT社  
組み込み用半導体レーザ



Laserline社  
レーザー加工装置

### 情報通信機器



Microsemi社  
ネットワークタイムサーバー



Spirent社  
GNSSシミュレータ

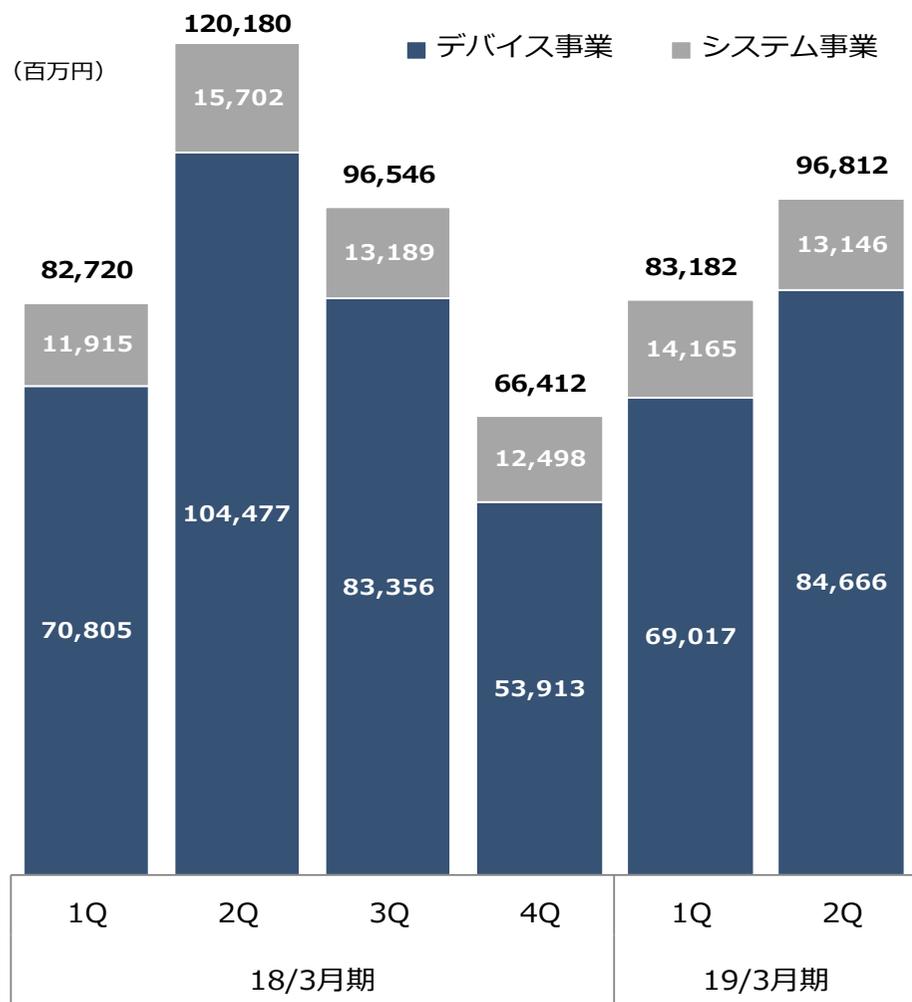
### 医用機器



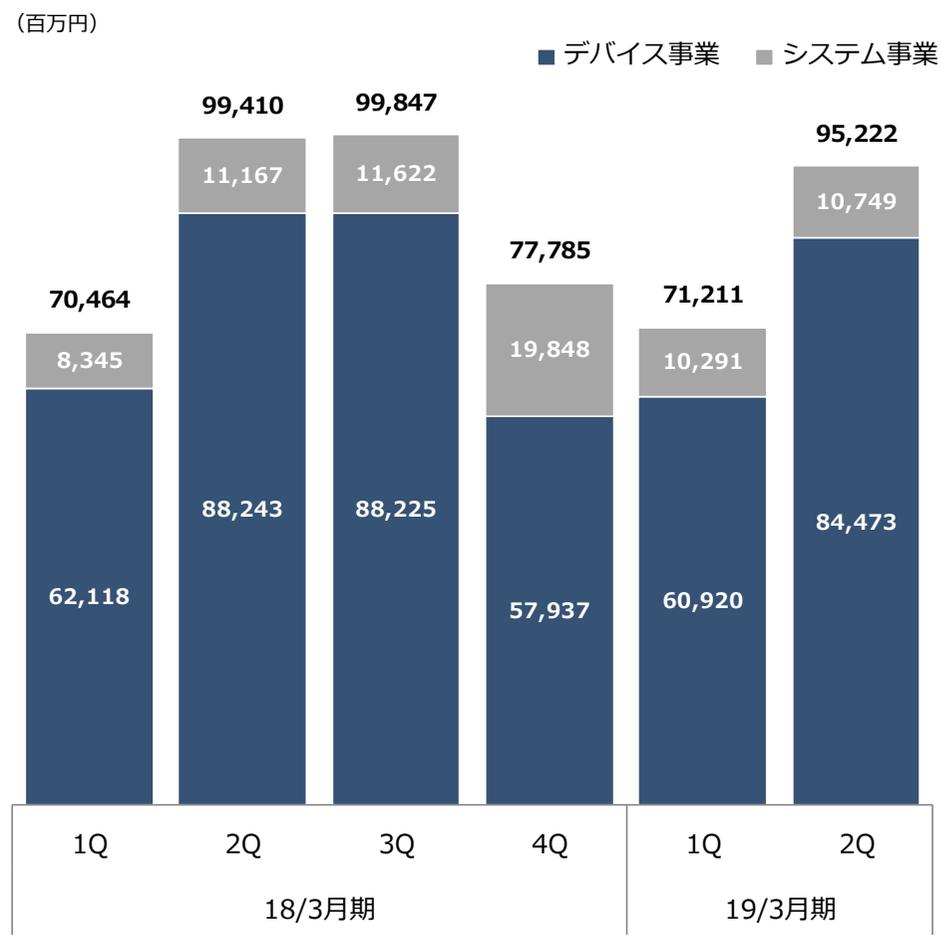
シーメンス・ジャパン社  
X線CT装置

# 業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高）

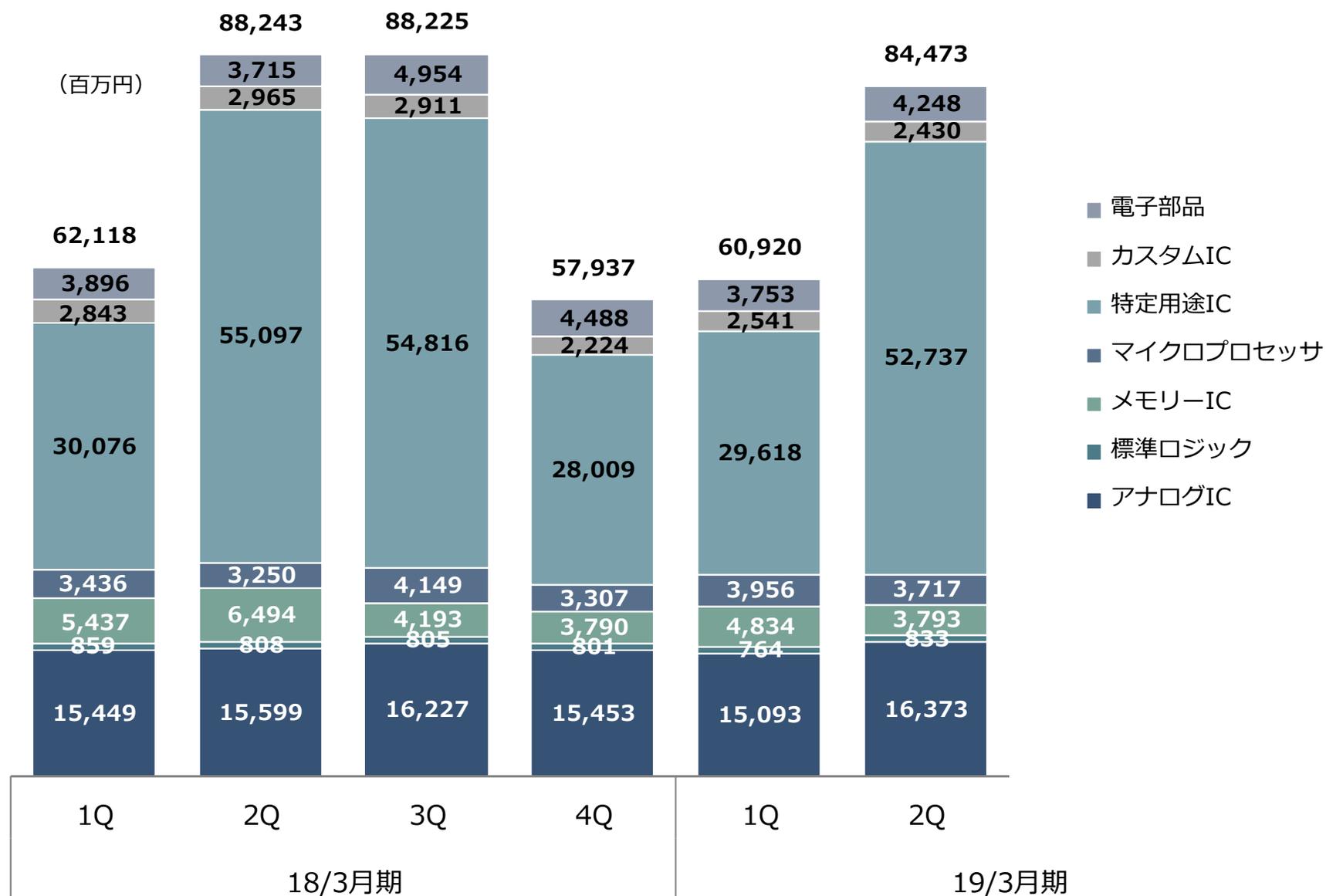
## 事業別受注高



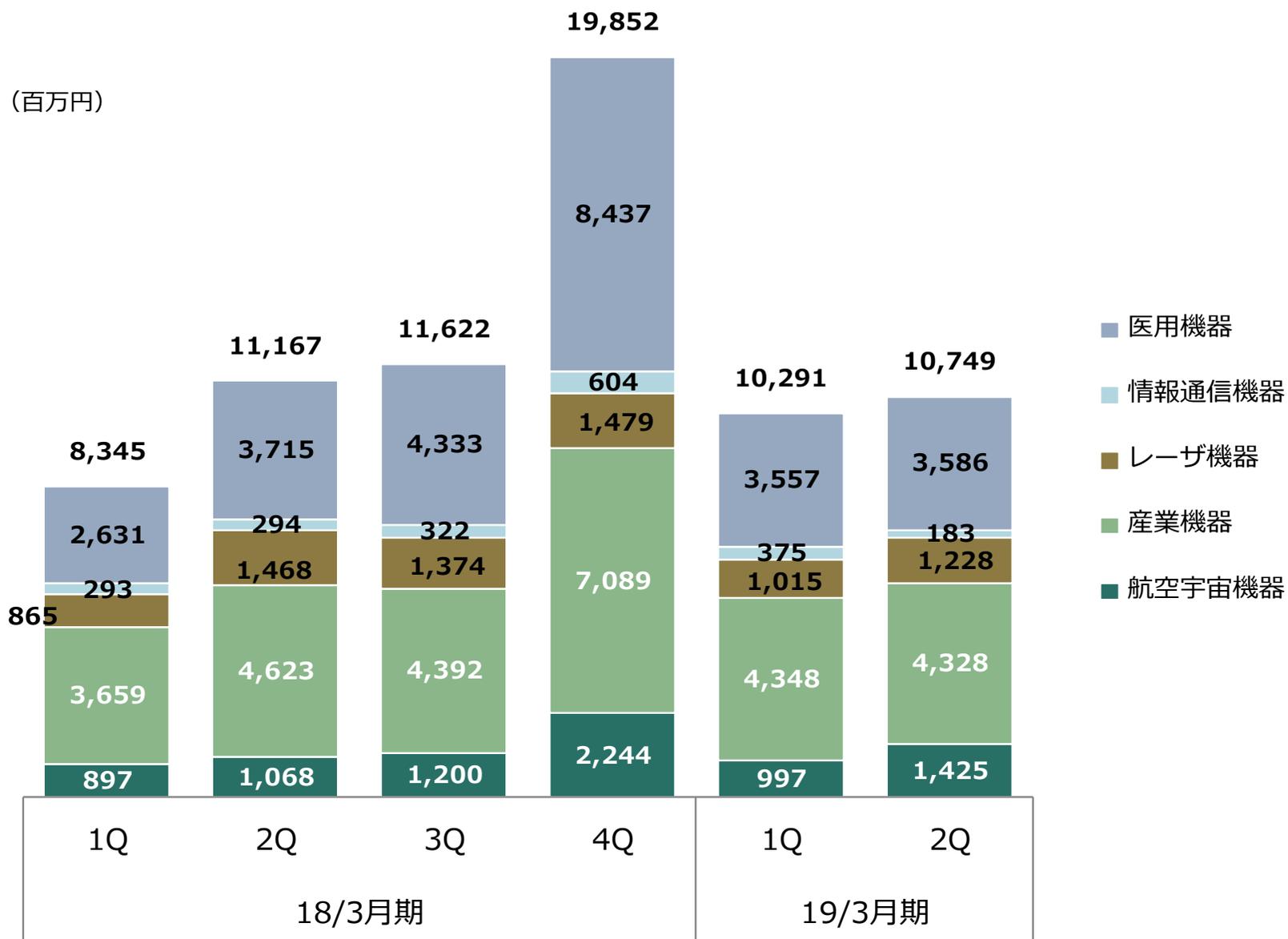
## 事業別売上高



# 業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）



# 業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）



## 本資料お取扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

### 本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

TEL 03-3639-3010

E-mail [ir@marubun.co.jp](mailto:ir@marubun.co.jp)